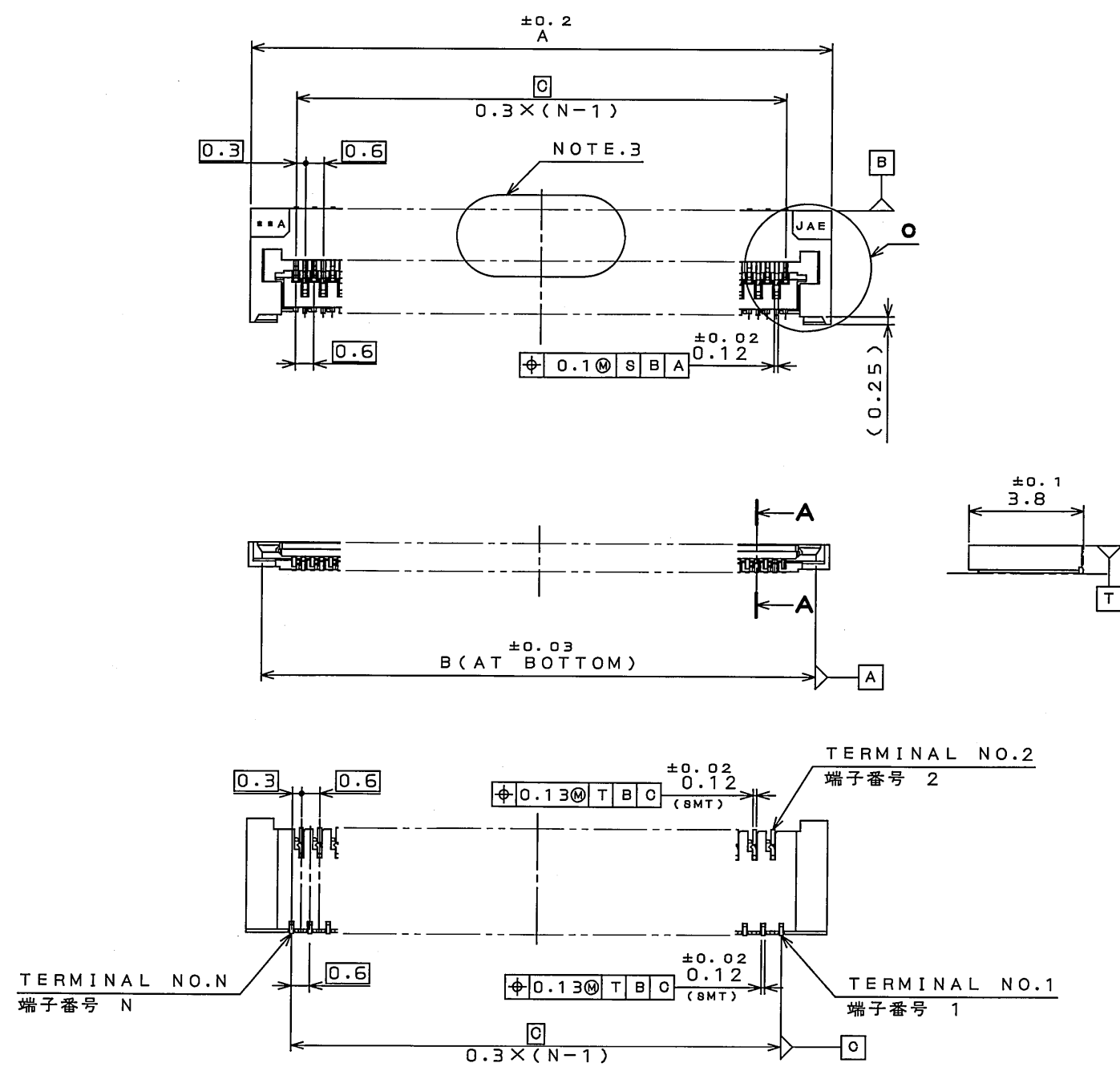
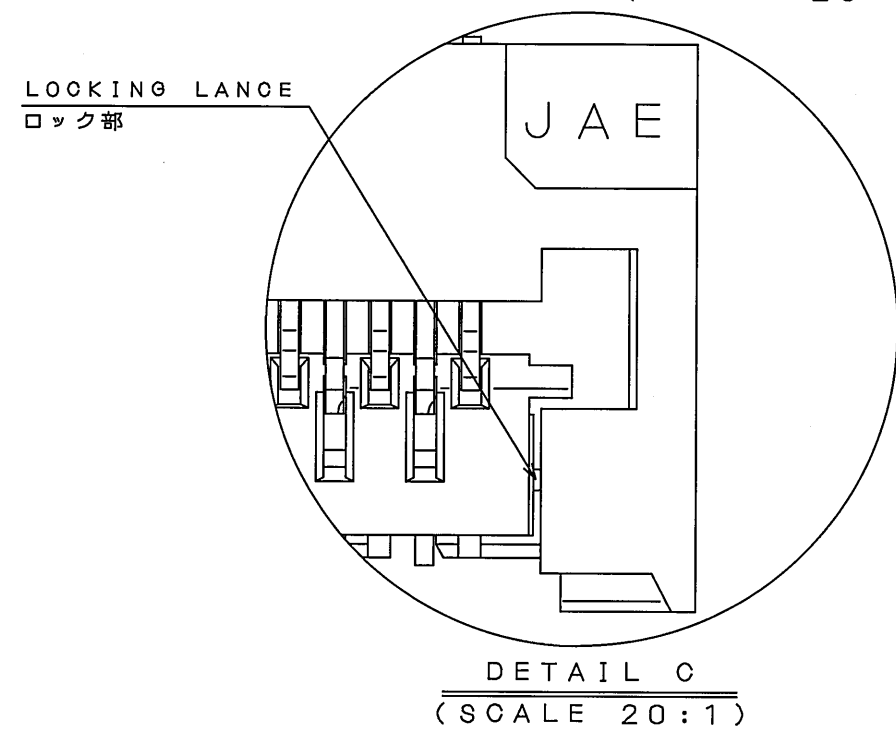
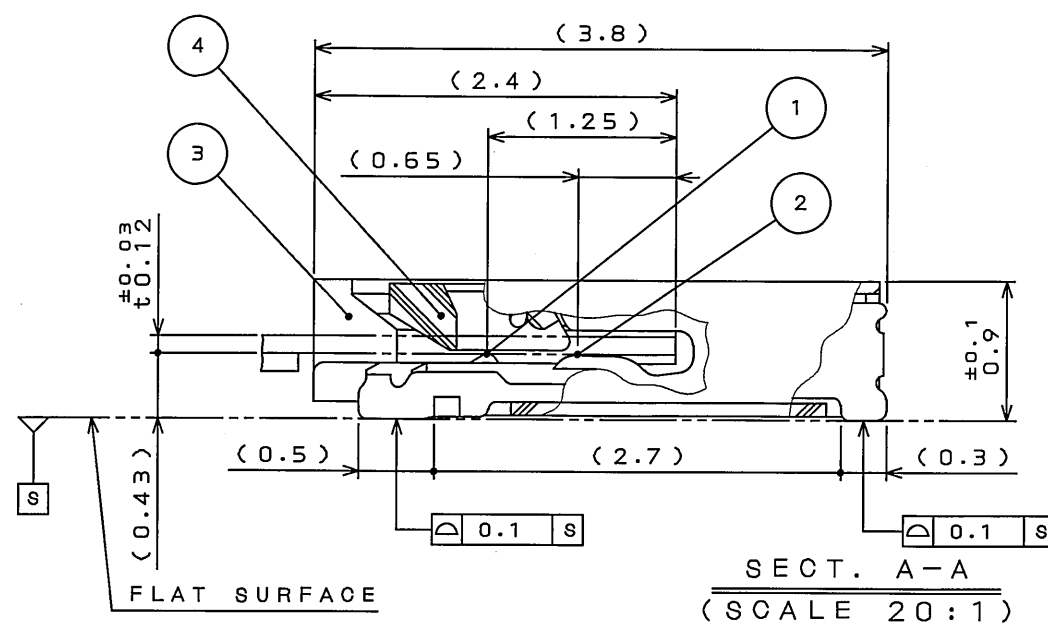
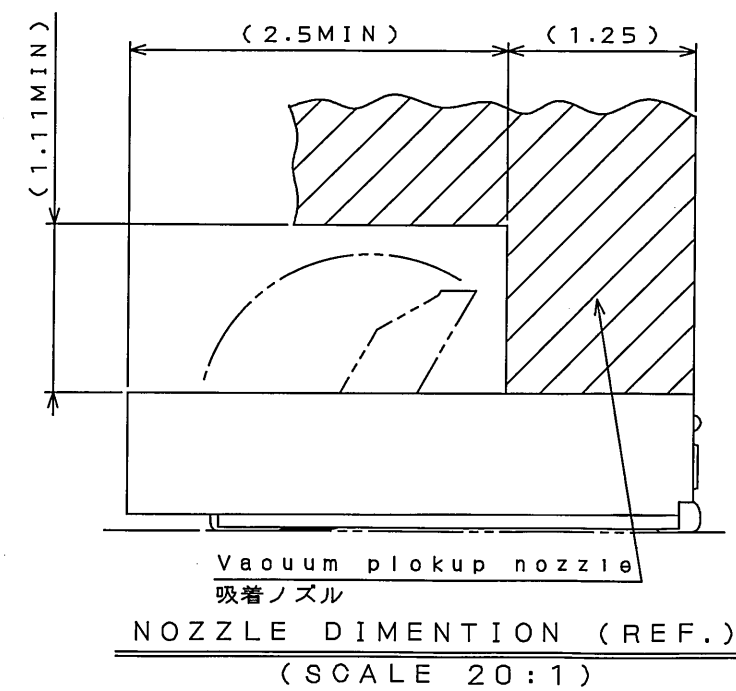


版 数 REV.	年月日 DATE	CON NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	19.Oct.2005	058469	ADDED NEW ITEMS	_____	K.INOUE	_____	O.HASHIGUCHI
3	24.Nov.2005	058588	ADDED NEW ITEMS	_____	K.INOUE	_____	O.Hashiguchi

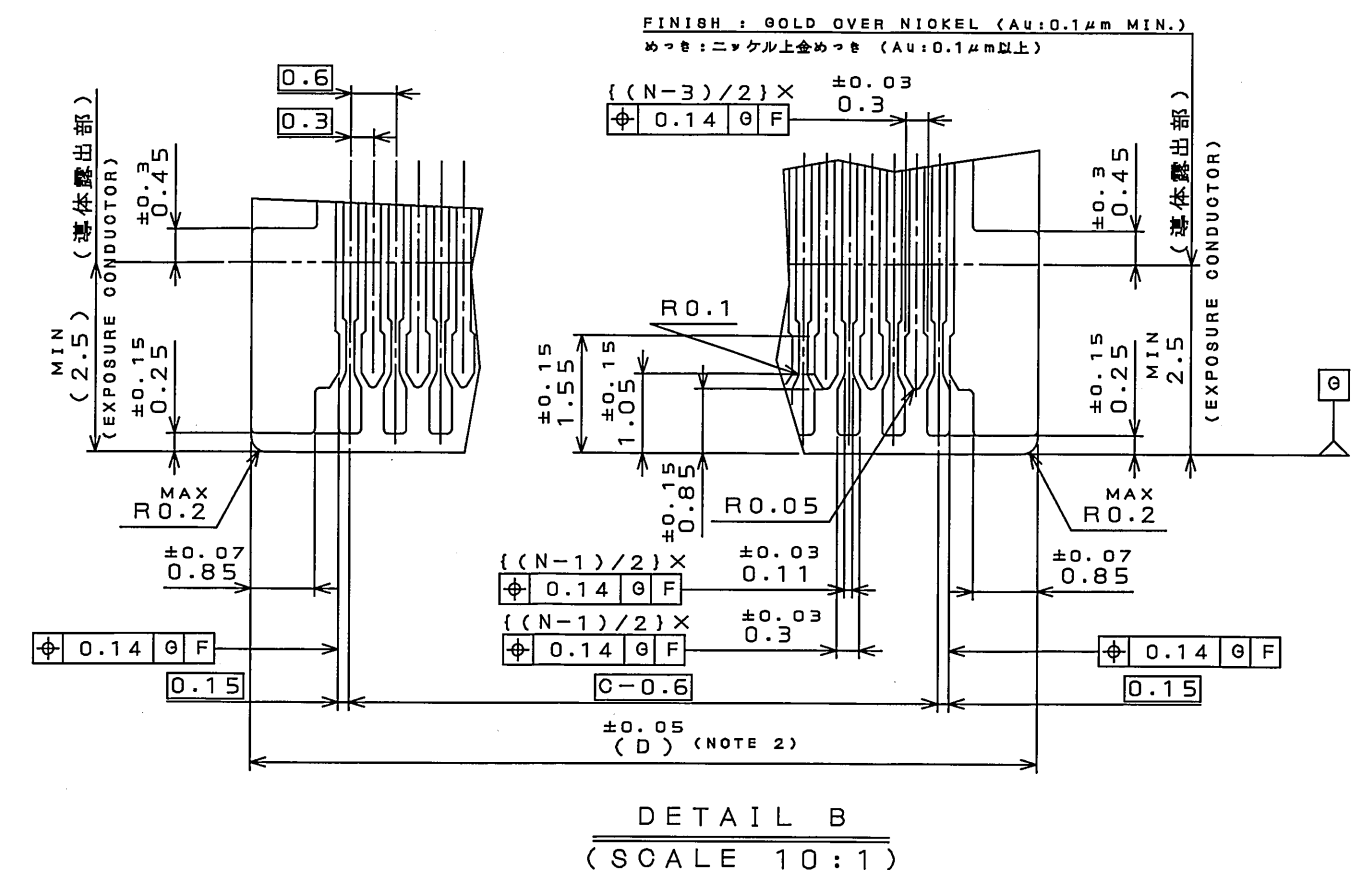
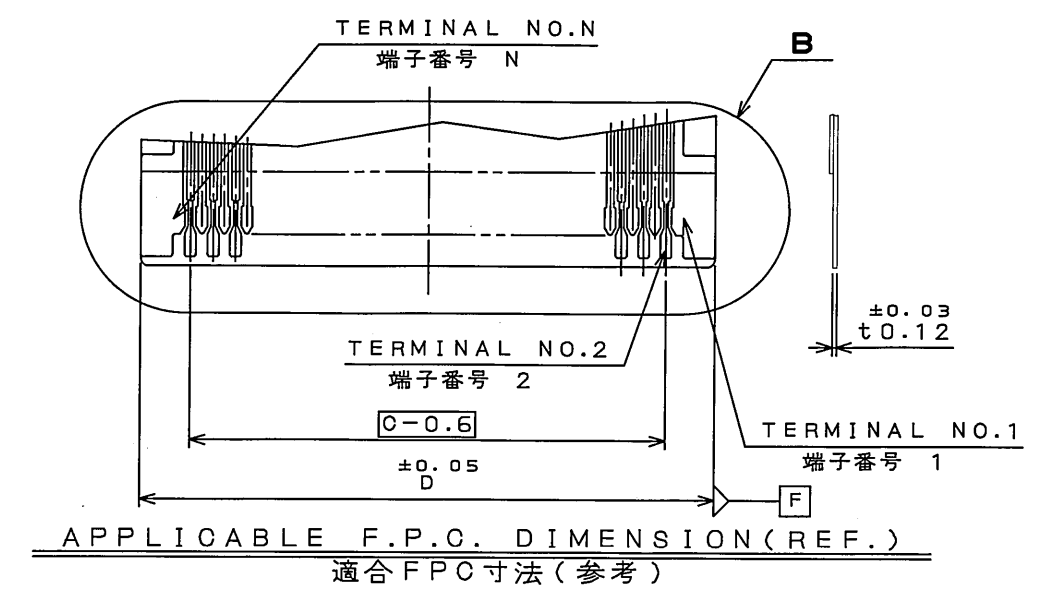
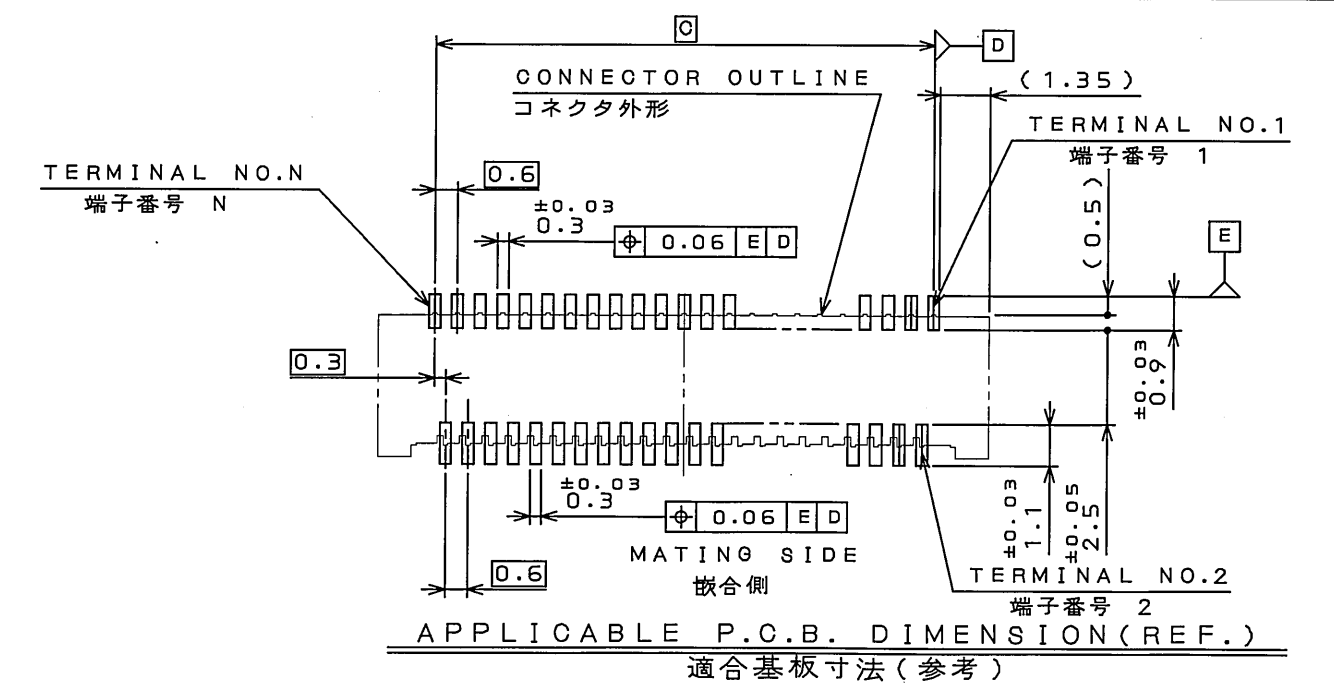


	PRODUCT NO. 品名	A	B	C	D
△	FF0285658V1	22.2	21.31	19.2	21.2
	FF0285558V1	19.2	18.31	16.2	18.2
△	FF028456V1	16.2	15.31	13.2	15.2
△	FF028358V1	13.2	12.31	10.2	12.2
△	FF028338V1	12.6	11.71	9.6	11.6
△	FF028318V1	12.0	11.1	9.0	11.0
△	FF028298V1	11.4	10.51	8.4	10.4
△	FF028278V1	10.8	9.91	7.8	9.8
△	FF028258V1	10.2	9.31	7.2	9.2
△	FF028178V1	7.8	6.91	4.8	6.8
△	FF028158V1	7.2	6.31	4.2	6.2



NOTE 1. REFER TO TABLE2 ABOUT RCOMMENDED FPC COMPOSITION.
NOTE 2. TOERANCE OF DIMENSION D IS
RECOMMENDED TO BE ± 0.05 IN ORDER TO
IMPROOVE PRECISION OF PITCH POSITIONING
AND CONNECTION RELIABILITY.
NOTE 3. LOT NUMBER IS MARKED ON THE TOP CENTER
PORTION OF THE CONNECTOR.

COMPOSITION 層名		RECOMMENDED 推奨
GOLD PLATING 金めっき	ELECTROLYSIS PLATING 電解めっき	0.1 μm MIN
NICKEL PLATING ニッケルめっき	ELECTROLYSIS PLATING 電解めっき	SOFT TYPE IF AVAILABLE
COPPER 銅箔	ROLLED MATERIAL 圧延銅	NOMINAL 18 μm MAX
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性	NONE (RECOMMENDED)
BASE FILM ベースフィルム	POLYIMIDE ポリイミド	25 μm
ADHESIVE 接着剤	THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性	30 μm MAX
REINFORCE PLATE 補強板	POLYIMIDE ポリイミド	—



4	ACTUATOR アクチュエータ	1	PPS	_____	COLOR:BLACK/色相:黒 UL74V-V0
3	BASE INSULATOR ベースインシュレータ	1	LCP	_____	COLOR:WHITE/色相:白 UL74V-V0
2	CONTACT 2 コンタクト 2	(N-1) 2	COPPER ALLOY 銅合金	PARTIAL GOLD OVER NICKEL(AVG.1mm MIN.) ニッケル上部分金(AVG.1mm 以上)	_____
1	CONTACT 1 コンタクト 1	(N-1) 2	COPPER ALLOY 銅合金	PARTIAL GOLD OVER NICKEL CONTACT(AVG.12mm MIN) ニッケル上部分金 CONTACT(AVG.12mm 以上) TERMINAL(AVG.03mm MIN) 端子(AVG.03mm 以上)	_____
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE) 14.Jul.2005		尺度(SCALE) 5:1	シリーズ(SERIES) FF02S
JACS-10293-*		製図 DR.	_____	名称(TITLE) FF02S**SV1 (ODD NUMBER OF CONTACTS) (奇数芯数)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 
公差(GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	K.INOUE		
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	査閲 APPD.	_____		
. ±0.8	X° ±	承認 APPD.	O.HASHIGUCHI	質量(MASS)	図面番号(DRAWING NO.) SJ104079
.X ±0.4	X°X' ±				版数 (REV)
.XX ±0.1					3
.XXXX ±					

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9